

## 关键指标

- 频率范围：2.7~3.5GHz
- 移相精度均方根：2°
- 低插入损耗：5.5dB
- 负电压控制
- 外形尺寸：6mm×6mm×1.2mm

## 典型应用

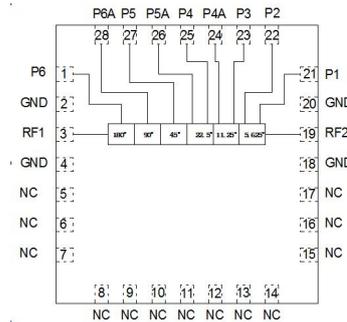
- 电子对抗
- 天气&军事雷达
- 卫星通信
- 波控模块
- 调相

## 产品简介

XT3305Q6 是一款波段六位数控移相器封装芯片，采用 GaAs 0.5μm-pHEMT 工艺制作，移相步进 5.625°，插入损耗 5.5dB，移相精度均方根为 2°，0/-5V 逻辑电平控制移相。

该裸片封装于 6×6mm QFN 壳体中。

## 功能框图



## 电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, 控制电平=0/-5V, 50Ω系统)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率	2.7~3.5			GHz
RF1 回波损耗	—	-20	—	dB
RF2 回波损耗	—	-20	—	dB
插入损耗	—	-5.5	—	dB
幅度波动	—	±0.5	—	dB
移相精度	—	±3	—	°
移相精度均方根	—	2	—	°

## 真值表 (0: 0V, 1: -5V)

相位	P1	P2	P3	P4	P4A	P5	P5A	P6	P6A
零度	0	0	0	0	1	0	1	0	1
-5.625°	1	0	0	0	1	0	1	0	1
-11.25°	0	1	0	0	1	0	1	0	1
-22.5°	0	0	1	0	1	0	1	0	1
-45°	0	0	0	1	0	0	1	0	1
-90°	0	0	0	0	1	1	0	0	1
-180°	0	0	0	0	1	0	1	1	0
-354.375°	1	1	1	1	0	1	0	1	0

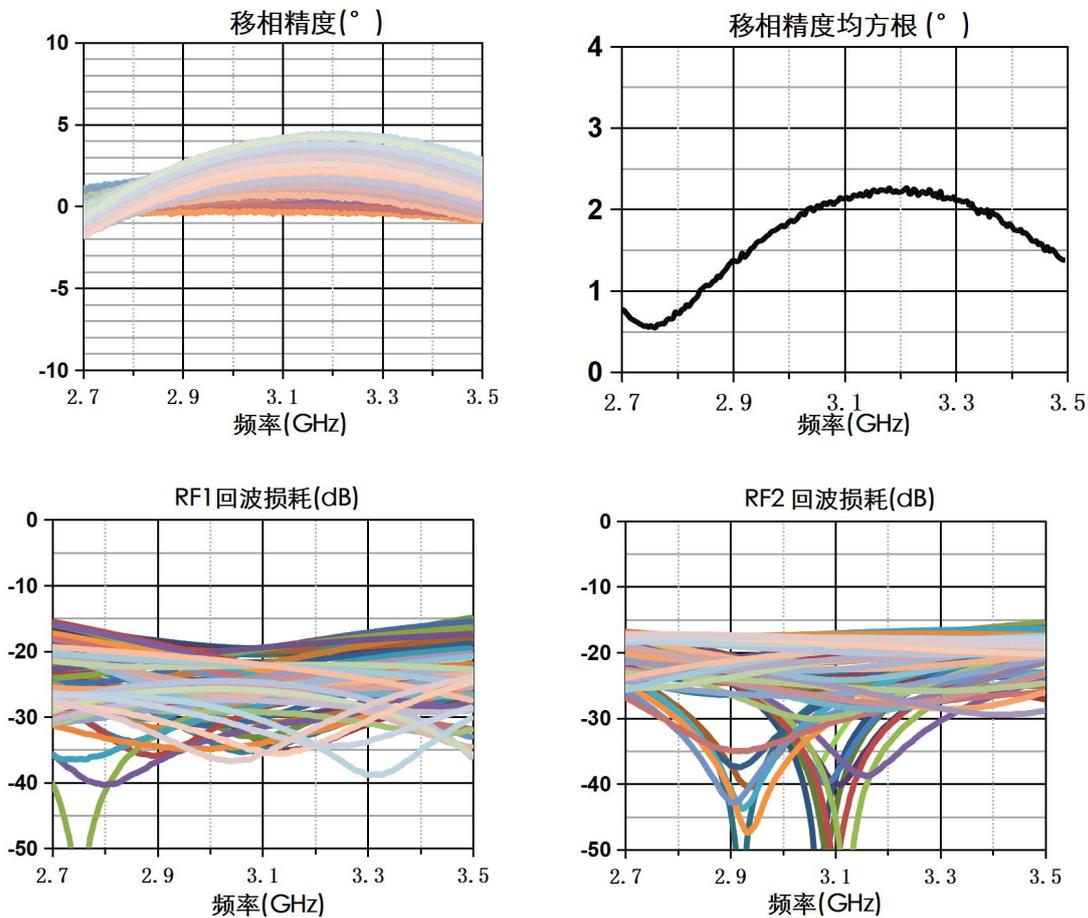
### 绝对最大额定值

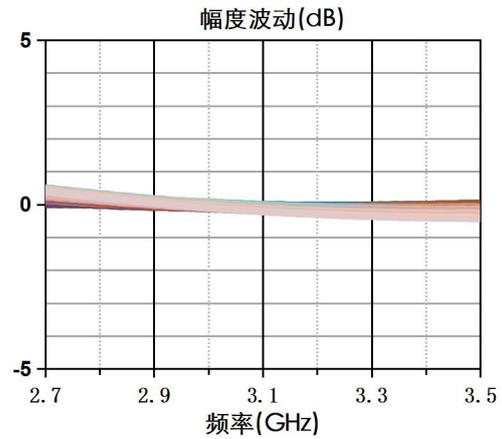
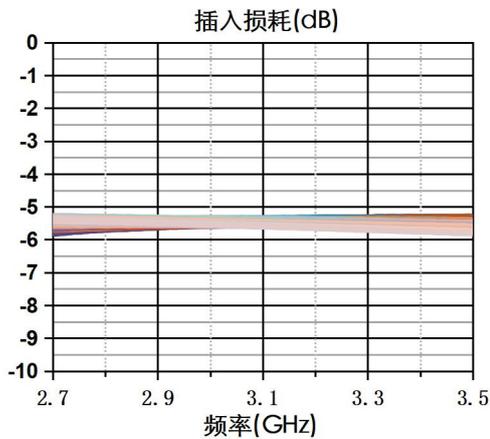
最大输入功率	+23dBm	工作温度	-55°C~+85°C
最大输入电压	-8V	贮存温度	-65°C~+150°C

### 控制电压

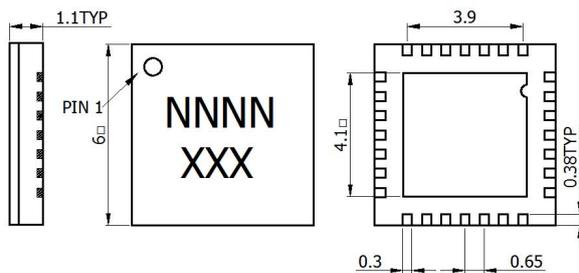
状态	偏置条件
低	0~0.2V
高	-5.5~4.5V

### 典型测试曲线

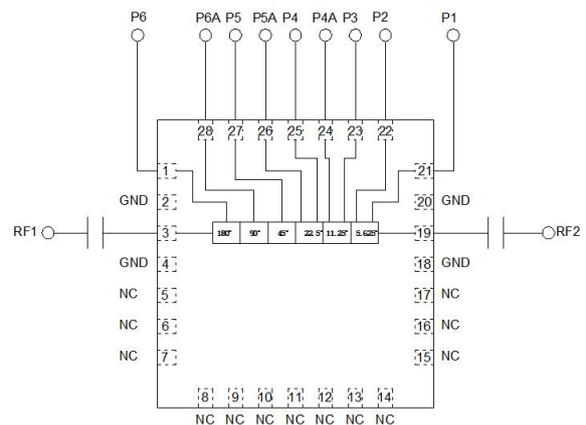




## 外形和端口尺寸 (mm)



## 推荐装配图



### 注意事项:

- 1、产品防潮等级为 2a 级，存放环境小于或等于 30° C/60% RH，四周车间寿命；
- 2、撤除真空包装，上回流焊前需在 125+/-5° 环境中烘焙 6 小时，方可焊接。